

锦州神工半导体股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料



二〇二一年五月

目录

2020 年年度股东大会会议须知	3
2020 年年度股东大会会议议程	6
一、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》	8
二、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	9
三、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	14
四、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》	17
五、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	19
六、《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》	20
七、《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》	21
八、《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》	22
九、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	23
十、《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》	26

2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《锦州神工半导体股份有限公司章程》、《锦州神工半导体股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2020 年年度股东大会会议须知：

一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司证券办公室严格按照程序安排会务工作。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止。

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前向股东大会会务组进行登记。股东大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不宜过长。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场进行见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议政策程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号 2021-013）。

特别提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，需参加现场会议的股东采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作，体温正常且无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。

2020 年年度股东大会会议议程

会议时间：2021 年 5 月 14 日下午 14:00 开始

会议地点：锦州市太和区中信路 46 号甲公司会议室

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长潘连胜先生

会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
- 二、见证律师确认与会人员资格；
- 三、主持人宣布会议开始；
- 四、主持人宣读会议须知；
- 五、宣读本次股东大会相关议案：
 - 1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
 - 2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
 - 3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
 - 4、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；
 - 5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；
 - 6、《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》；
 - 7、《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》；
 - 8、《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》；
 - 9、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
 - 10、《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》。
- 六、股东或股东代表进行讨论；
- 七、选举监票人和计票人；
- 八、与会股东与股东代表对各项议案投票表决；
- 九、统计并宣布现场表决结果；
- 十、休会，等待接收网络投票结果；

十一、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；

十二、主持人宣读股东大会决议；

十三、见证律师宣读法律意见书；

十四、签署会议文件；

十五、主持人宣布会议结束。

一、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东和股东代表：

公司已于 2021 年 04 月 19 日披露了《锦州神工半导体股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要，具体内容可在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》查阅。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过。现提请各位股东和股东代表认真审议。

2021 年 05 月 14 日

二、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告

一、2020 年公司经营概述

2020 年全球经济形势错综复杂，经贸纷争此起彼伏，疫情引发的严防严控冲击服务业和制造业，全球经济下行压力巨大。不过，半导体行业经受住了宏观经济环境的挑战，稳中有升，世界半导体贸易统计组织（WSTS）2021 年 3 月公布的报告显示，2020 年全球半导体销售额达 4,404 亿美元，同比增长 6.8%

纵观国内，半导体行业正处于 5G 代际切换窗口，手机、新能源车汽车、HPC（服务器、矿机等）、物联网等多重需求快速提升。上半年受中美贸易争端尤其是全球疫情影响，半导体行业国产化加速，国内产能持续紧张。

在晶圆制造端，由于车载摄像头芯片、电源管理芯片、NOR 存储器芯片等应用需求快速增长，导致 8 英寸硅片产能紧张程度高于 12 英寸，当前国内只有少数厂商实现了 8 英寸硅片量产，大量产能缺口依赖进口补充。不过，在半导体行业走向国产替代的必然趋势下，中国各主要晶圆厂陆续计划扩产，上游半导体材料有望迎来国产替代和下游晶圆厂扩产采购需求。

报告期内，公司所处硅材料细分行业在整个半导体产业链上游，经营业绩与下游半导体行业景气度高度相关。上半年受疫情影响，尽管公司新签订订单金额自 2 月起逐月增加，二季度营业收入比一季度大幅增加 60.96%，但收入较去年同期高点相比仍有下降。下半年随着半导体行业景气度复苏，公司受益晶圆制造端需求传导，业绩大幅回升，2020 年全年，公司实现营业收入 19,209.75 万元，比去年同期上升 1.86%；归属于上市公司股东的净利润 10,027.65 万元，比去年同期上升 30.31%。

2021 年以来，国内晶圆制造端景气度延续，国产替代持续向上游材料环节扩散，国内半导体材料行业企业有望受益。

公司具体工作开展情况如下：

（一）国内外市场拓展

新冠疫情导致货物跨境运输受阻、跨国经贸活动受限，公司境外客户的服务

和拓展受到一定影响。鉴于全球疫情防控的发展，公司适时调整销售策略，加大国内市场拓展力度。一方面公司通过与国内刻蚀机厂家共同研发合作，为其提供硅电极完成品，共同推进半导体产业国产化的步伐。另一方面公司利用子公司福建精工的精密加工能力，完成从大直径单晶硅材料到硅零部件（硅上电极、硅托环）的生产延伸，向国内终端集成电路制造商推广、销售。该产品逐步批量生产，获得数家 8 英寸、12 英寸集成电路制造厂商的评估机会，通过了国内干法刻蚀机制造商的评估，并得到部分集成电路制造厂商的长期批量订单。这标志着公司打破了依赖海外市场的单一模式，增强了应对区域性销售波动的抗风险能力。

（二）研发情况

公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，公司通过构建科学合理的研发体系，使公司研发方向能够始终紧随行业前沿步伐，又能紧密贴合客户实际需求。目前公司已成功进入国际先进半导体材料产业链体系，并在相关细分领域形成了一定的优势。

2020 年，20 英寸以上超大直径单晶硅产品研发项目已取得重大突破。公司使用 28 英寸热场成功拉制直径达到 550mm（22 英寸）的晶体。此技术达到世界先进水平。公司今后将继续努力，优化热场，取得更多试验数据，继续提高良品率。

公司在硅零部件的高精度加工方面也取得重大突破。针对 12 英寸刻蚀设备客户的需求，公司研发团队积极跟进，取得了关键零部件的产品认证；同时，配合客户做下一代先进制程设备的零部件的研发工作，实现新机台的配套；在项目开发过程中，公司在微孔加工和螺纹加工方面取得了核心技术的突破，成功按时交付了客户要求的全套零部件，获得客户的认可。

（三）募投项目进展

报告期内，公司积极推进募投项目建设，公司 8 英寸半导体级轻掺低缺陷单晶硅材料研发团队通过持续不断的技术试验，实现了热系统封闭、多段晶体电阻率区间控制、晶体稳态化控制，目前已成功完成晶体生长；晶体已通过严格的缺陷分析检验，晶体的 COP 等原生缺陷已得到有效控制，可以初步满足集成电路客户对硅片缺陷密度的需求。公司将继续加大研发投入，优化各种工艺，不断提高良品率。公司半导体级 8 英寸半导体级轻掺低缺陷抛光硅片项目有序推进，设

备调试及工艺实验同步进行。

二、行业格局和趋势

经过半个世纪的发展，半导体广泛渗透于信息、通信、计算机、消费电子、汽车等各个领域，半导体产品对人们的日常生活和消费形态产生了显著的影响。5G、人工智能、物联网、大数据等新应用领域的兴起，逐渐成为半导体行业下一代技术革新的驱动力量。半导体产业作为现代信息产业的基础和核心产业之一，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在推动国家经济发展、社会进步、提高人民生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用，已成为当前国际竞争的焦点和衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。

长期来看，半导体行业的增速波动与全球 GDP 波动的相关性呈现高度一致（2010 至今，相关系数为 0.57）。半导体行业存在受 GDP 增速影响的需求周期在行业内已成为共识。另一方面，半导体产业分工的出现使得行业出现了以核心企业的产能波动为主导的供给周期。综合来看，以 GDP 增速表征的需求周期和行业龙头产能变化的供给周期两个因素共同叠加，构成了半导体周期。

2016 年度至 2018 年度，全球半导体行业处于行业周期上行阶段，行业景气度较高，带动半导体材料特别是硅材料市场需求增长。2019 年，由于手机、电脑等终端市场需求有所放缓，加之全球半导体产业出现了一定的反全球化的现象，导致半导体材料行业市场规模有所缩减。2020 年 Q1 以来，半导体行业调整逐步进入尾声，景气度逐渐复苏。叠加 5G、物联网、智能驾驶等下游需求开始放量，半导体行业市场迎来上行周期。根据 SEMI 统计，2020 年全球半导体材料市场销售达 553 亿美元，较上年增长 4.9%。其中，全球晶圆制造材料总营收达 349 亿美元，同比增长 6.5%；封装材料总营收达 204 亿美元，同比增长 2.3%。

相比全球半导体市场，中国半导体市场虽受全球整体因素影响，但依旧保持了相对良好的走势。据中国半导体行业协会统计，2020 年中国集成电路产业销售额为 8,848 亿元，同比增长 17%。其中，集成电路设计业销售额为 3,778.4 亿元，同比增长 23.3%；集成电路制造业销售额为 2,560.1 亿元，同比增长 19.1%；封装测试业销售额 2,509.5 亿元，同比增长 6.8%。

我国政府先后出台了一系列规范和促进集成电路行业发展的法律法规和产业政策，同时通过设立产业投资基金、鼓励产业资本投资等多种形式为行业发展提供资本助力。

三、公司发展战略

公司以“科技创新、技术报国”为宗旨，以“专注技术、强调质量、服务客户”为经营理念，致力于成为在全球半导体级单晶硅材料领域内，有市场地位、有技术优势和研发实力、有高性价比产品、有良好品质管理及售后服务的优秀硅材料供应商。

未来，公司将继续依托自身的技术优势及丰富的半导体市场经验，增加技术研发投入，提高生产管理效率，并紧密围绕“半导体材料国产化”的国家战略，成为中国乃至世界半导体硅材料领域的领先者。

四、2021 年经营计划

近年来，国内半导体材料市场发展迅猛，据 SEMI 报告指出，2020 年中国大陆半导体材料市场规模达 97.63 亿美元，同比增长 12%，超过韩国成为全世界第二大半导体材料市场。虽然中国半导体行业整体销售规模持续扩张，但半导体材料及设备依然严重依赖进口，国产化进程严重滞后于国内快速增长的市场需求，进口替代空间巨大。

公司是国内领先的单晶硅材料及应用产品供应商，主营业务为单晶硅材料及应用产品的研发、生产和销售。2021 年，公司拟定如下经营目标：

1、大直径单晶硅材料领域

紧跟行业前沿客户的研发步伐，继续优化大直径单晶硅材料的工艺手段，提升成品率和产量。关注半导体刻蚀机的研发动态，储备多晶质硅材料制造技术。

在市场开拓上，公司将继续深耕重点客户，在巩固与重点客户长期稳定的良好合作关系同时，注重与国内半导体行业新兴设备厂商及终端集成电路客户的接触，逐步发展国内的销售网络，抓住国内半导体行业发展的机遇，扩大国内市场销售的份额。

2、硅零部件领域

公司已开发了适用于 8 英寸、12 英寸等不同晶圆尺寸刻蚀机的硅零部件产

品，并得到数家国内集成电路厂商的认证机会，在基础上公司将推进客户端的评估进程，争取更多客户的评估认证通过，从而取得更多的长期、批量订单，同时增加生产设备，扩大产能，通过规模化生产，提高生产效率，降低成本，构筑市场竞争力。

3. 半导体级大尺寸硅片领域

公司目前已成功完成半导体级 8 英寸轻掺低缺陷硅晶体生长的工艺研发，并在各项指标上取得了一定的进展；接下将继续加大研发投入，优化各种工艺，提高生产效率，并扩大生产规模，保持长期稳定的量产状态下的高良率。积极探索研发“半导体级 12 英寸轻掺低缺陷硅晶体”。公司在半导体 8 英寸抛光片产品上，一方面将增加投片数量，逐步提高每道工序的良率水平，确保全产线的规模化生产良率达到业内一流厂商的平均水平。另一方面，利用在行业中长期积累的丰富客户资源及良好的品牌知名度，得到半导体 8 英寸抛光硅片的客户认证机会，为后续评估验证工作奠定基础。

4. 在人才引进上

2021 年，面对国内半导体高端人才紧缺的局面，公司将着眼于国际半导体行业，引进有着丰富生产、管理经验的复合型专家；同时吸纳国内有一定基础的中端技术人员；建立起自己的技术人才梯队，提升公司的人才竞争优势。

上述议案请各位股东和股东代表认真审议。

锦州神工半导体股份有限公司

董事会

2021 年 05 月 14 日

三、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

2020年度财务决算报告

2020年度，锦州神工半导体股份有限公司年财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2021]第1-10376号标准无保留意见的审计报告，公司财务决算情况如下：

一、2020年总体经营业绩回顾

报告期内，公司实现营业收入19,209.75万元，其中硅晶体15寸以下产品实现收入6,339.08万元，比上年同期增加52.08%；硅晶体15-16寸产品实现收入7,569.49万元，比上年同期减少30.72%；硅晶体16寸以上产品实现收入4,332.87万元，比上年同期增加15.38%。实现营业利润11,222.45万元，较上年同期增加23.23%；归属于上市公司股东的净利润10,027.65万元，较上年同期增加30.31%；经营活动产生的现金流量净额为14,492.30万元，较上年同期增加28.40%。

二、报告期内公司经营业绩分析

1、资产、负债状况

公司2020年末总资产134,856.78万元，同比增长250.60%；负债总额13,672.11万元，同比增长471.02%；归属于上市公司股东的所有者权益总额121,184.66万元，同比增加235.97%；资产负债率为10.14%。

其中，（1）货币资金较上期末增加377.56%，主要系公司本年募集资金到账所致；（2）交易性金融资产较上期末增加334,365,753.66元，主要系募集资金购买结构性存款、理财产品所致；（3）应收账款较上期末增加119.31%，主要系行业回暖销售额增加所致；（4）预付款项较上期末增加210.36%，主要系行业回暖、订单增加，购买原材料增加所致；（5）固定资产较上期末增加96.86%，主要系使用募集资金采购大型设备以及在建工程转固所致；（6）在建工程较上期末增加16,892.43%，主要系使用募集资金采购大型设备以及购建工程所致；（7）其他非流动资产较上期末增加1,059.54%，主要系募投项目购买设备、购建工程预

付款增加所致；（8）递延所得税资产较上期末增加73.35%，主要系递延收益增加产生财税差所致；（9）应付账款较上期末增加1,223.96%，主要系募投项目购买设备应付所致；（10）应交税费较上期末增加1,918.94%，主要系计提当年所得税所致；（11）递延收益较上期末增加96.86%，主要系本期收到与资产相关政府补助所致。

2、期间费用及所得税费用分析

单位：人民币万元

费用项目	2020年度	2019年度	同比增减幅度（%）	2018年度
销售费用	295.48	292.46	1.03	289.29
管理费用	2,289.83	2,654.58	-13.74	4,653.44
研发费用	1,790.11	989.40	80.93	1,090.89
财务费用	-1,210.52	-137.94	-777.54	-225.03

（1）研发费用增加80.93%，主要系募投项目本期开始研发所致；

（2）财务费用减少777.54%，主要系使用闲置募集资金进行现金管理所致。

3、现金流量状况

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	230,241,699.15	236,213,791.60	-2.53
经营活动现金流出小计	85,318,658.66	123,348,613.34	-30.83
经营活动产生的现金流量净额	144,923,040.49	112,865,178.26	28.40
投资活动现金流入小计	19,223,232.77	109,046,164.38	-82.37
投资活动现金流出小计	497,504,311.64	108,713,825.26	357.63
投资活动产生的现金流量净额	-478,281,078.87	332,339.12	-144,013.57
筹资活动现金流入小计	792,750,566.07		
筹资活动现金流出小计	46,702,074.89	50,485,766.00	-7.49
筹资活动产生的现金流量净额	746,048,491.18	-50,485,766.00	1,577.74

现金及现金等价物净增加额	408,836,439.71	63,187,797.48	547.02
--------------	----------------	---------------	--------

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少144,013.57%，主要系使用募集资金购买设备、购建工程以及使用闲置募集资金进行现金管理所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,577.74%，主要系募集资金到账所致。

4、主要数据及财务指标

单位:人民币元

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减(%)	2018 年
营业收入（元）	192,097,477.36	188,586,021.47	1.86	282,535,675.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,276,468.28	76,949,820.93	30.31	106,575,958.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,644,425.04	76,184,570.27	17.67	132,852,815.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,923,040.49	112,865,178.26	28.40	114,234,370.86
基本每股收益（元/股）	0.65	0.64	1.56	0.90
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.64	1.56	0.90
净资产收益率（%）	9.62	22.16	-12.54	41.76
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年 末增减(%)	2018 年末
总资产（元）	1,348,567,761.67	384,648,253.60	250.60	360,966,180.04
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,211,846,637.14	360,704,903.17	235.97	334,351,434.96

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过。现提请各位股东和股东代表认真审议。

锦州神工半导体股份有限公司

董事会

2021 年 05 月 14 日

四、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

2021 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为锦州神工半导体股份有限公司及其下属子公司（以下简称“公司”）。

本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合 2021 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划等，按照合并报表口径进行测算并编制。

二、预算编制基本假设

1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关优惠政策无重大变化；
2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
3. 国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；
4. 公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；
5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2021 年度主要财务预算指标

2021 年度公司预算目标：以 2020 年的营业收入为基数，2021 年的营业收入增长率在 0-45%之间；2021 年扣除非经常性损益净利润增长率在 0-15%之间，上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润。

四、风险提示

上述财务预算仅为公司 2021 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识，

并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

上述议案请各位股东和股东代表认真审议。

锦州神工半导体股份有限公司

2021 年 05 月 14 日

五、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

各位股东和股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 159,792,842.62 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至公告日，公司总股本 160,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 15.96%。

本次利润分配完成后，公司剩余可分配利润结转至下一年度。

上述议案请各位股东和股东代表认真审议。

2021 年 05 月 14 日

六、《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》

各位股东和股东代表：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货业务相关业务资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求。董事会拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会结束时止。2021 年度财务报表审计费用为 60 万元，内控审计费用为 20 万元，与 2020 年度相同。上述议案请各位股东和股东代表认真审议。

2021 年 05 月 14 日

七、《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》

各位股东和股东代表：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定 2021 年度公司董事薪酬方案如下：

非独立董事：公司不额外向公司非独立董事支付董事职位薪酬。

独立董事：公司向独立董事支付津贴，标准为每人每年度税后人民币 7.2 万元，按月发放。上述议案请各位股东和股东代表认真审议。

上述议案请各位股东和股东代表认真审议。

2021 年 05 月 14 日

八、《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

各位股东和股东代表：

公司不额外向公司监事支付监事职位薪酬。

上述议案请各位股东和股东代表认真审议。

2021 年 05 月 14 日

九、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年度监事会工作报告

2020年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职能认真规范地开展了工作，对公司依法运作情况，公司财务状况，董事、总经理及高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。现将一年的工作情况报告如下：

一、监事会2020年度工作

（一）监事会会议情况

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司建立了规范化的公司治理结构。公司的股东大会、董事会和监事会职责划分合理、清晰，并能得到切实执行。监事会按照公司章程和议事规则独立有效运行，召集、召开、表决、决议等程序均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，运作记录规范、完整。

2020 年度公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过了如下项议案：

会议名称	通过议案	
	序号	议案名称
第一届监事会第八次会议	1	《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》
	2	《关于公司上市后变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并变更工商登记的议案》
第一届监事会第九次会议	1	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第一届监事会第十次会议	1	《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
	2	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
	3	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

	4	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
	5	《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
	6	《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
	7	《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》
	8	《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
	9	《关于会计政策变更的议案》
第一届监事会第十一次会议	1	《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
第一届监事会第十二次会议	1	《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
	2	《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
第一届监事会第十三次会议	1	《关于公司 2020 年第三季度报告及正文的议案》

（二）检查公司财务情况

2020年，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，通过检查和审核，监事会认为2020年财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果。

（三）审核公司内部控制情况

公司已经建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。

（四）股东大会决议执行情况的独立意见

报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规和《公司章程》，对股东大会和董事会的召开程序、审议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理层履行自己的职责情况以及对公司管理制度的执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会决策

程序严格遵循相关法律法规和规章制度的要求，决策程序合法有效，且严格、高效执行股东大会的各项决议，运作规范，未发生有损股东利益的行为。

二、监事会2021年度工作计划

2021年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规章制度，认真履行监督职责，不断加强监督检查，促进公司朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展，切实维护公司及广大股东的合法权益。

上述议案请各位股东和股东代表认真审议。

锦州神工半导体股份有限公司

监事会

2021 年 05 月 14 日

十、《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》

各位股东和股东代表：

公司根据实际生产经营情况及业务发展的需要，拟变更公司的经营范围，变更事项最终以市场监督管理局核定为准，具体情况如下：

一、变更经营范围的情况

公司原经营范围：“生产、销售半导体级硅制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

拟变更经营范围：“新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；销售代理；进出口代理；贸易经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

二、修订《公司章程》

鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售半导体级硅制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件销售；集成电路芯

	片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；销售代理；进出口代理；贸易经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	---

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

上述事项已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议通过并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。

2021 年 05 月 14 日